

マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ

～ 鉛フリー化によるマニュアルソルダリング ～

【主 催】

社団法人 日本溶接協会

マイクロソルダリング要員認証委員会、マイクロソルダリング要員認証評価委員会、マイクロソルダリング教育委員会

【開催日時および会場】

平成18年10月11日（水） 10：30～17：00 於：財団法人 総評会館（お茶の水）

【開 催 趣 旨】

電子部品実装のさらなる微細・高密度化、EUでのRoHS規制に伴う鉛フリー化、車載電子機器の急増など、マイクロソルダリング技術を取り巻く環境に大きな変化が生じています。

エレクトロニクス製品製造においては、品質・信頼性の確保が最も重要です。マイクロソルダリング技術は、エレクトロニクス製品製造におけるキープロセスであり、材料・部品、信頼性レベルの多様化の状況下で、ソルダリング実装部の品質・信頼性を確保するには、マイクロソルダリングの原理原則に基づいたソルダリング教育を通じた技術の習得が重要です。

日本溶接協会では、マイクロソルダリング技術の教育および技術資格の認証を行ってきました。今回の「マイクロソルダリング技術 教育・認証フェスタ」では、当協会の行っている教育・認証制度を広く理解してもらおうとともに、最新のマニュアルソルダリング用機器・材料・評価装置の展示、最新の研究紹介を通じて、マイクロソルダリング実装の展開を知って頂くことを目的として企画しました。

特に事業主や責任者の方々に参加頂き、基盤技術としてのマイクロソルダリング技術・実装技術を深くご理解頂ければ幸いです。

【プ ロ グ ラ ム】

10:30-10:40	開 催 の 挨 拶	マイクロソルダリング要員認証委員会 委員長 恩澤 忠男
10:40-11:20	「自己組織化実装プロセス」 「熱・振動複合環境下での信頼性評価」	大阪大学大学院 教授 藤本 公三 低融点金属フィラー含有樹脂をデバイスと基板間に塗布し、加熱制御することで、金属フィラーを電極間のみ熔融凝集させる新たな実装プロセスと車載電子デバイスの実装部を対象とした熱・振動複合環境下での信頼性評価方法の研究を紹介する。
11:20-12:00	展示品紹介 (5分程度／1件)	太洋電機産業(株)、白光(株)、(株)ケイソニック、日本ゲスコ(株)、 エスペック(株)、ホーザン(株)、(株)レスカ、 (株)島津製作所、(株)ジャパンユニックス (順不同)
12:00-14:00	昼 食 休 憩 ・ 展 示 見 学	
14:00-14:40	「鉛フリーはんだへの微量元素添加による優位化」	大阪大学 接合科学研究所 教授 竹本 正 Sn-Ag-Cu基本系を変えての改善は困難であり、Sn-Ag-Cuに微量元素を添加することで、いくつかの特性改善が図られている。本講演ではこれまでの研究成果の概要と課題ならびに今後の指針などを紹介する
14:40-15:00	マイクロソルダリング技術賞表彰式	マイクロソルダリング要員認証委員会 委員長 恩澤 忠男
15:00-15:10	休 憩	
15:10-15:35	「東芝のはんだ付け教育の現状について」	(株)東芝 生産技術センター 加藤 正幸 (株)マニユファクチャリングソリューション 中嶋 宣行
15:35-15:50	「マイクロソルダリング技術資格制度の概要」	日本溶接協会 金子 謙
15:50-16:20	「鉛フリーはんだ使用作業での労働衛生管理のポイント」	中央労働災害防止協会 棗田 衆一郎
16:20-16:50	「キャリア形成促進助成金について」	雇用・能力開発機構 東京センター 遠山 弘行
16:50-17:00	閉 会 の 挨 拶	マイクロソルダリング教育委員会 委員長 藤本 公三

※ プログラムの内容は若干変更になる場合がありますので予めご了承下さい。

なお、最新詳細情報はホームページ「<http://www.jwes.or.jp/ms/>」を参照願います。

<< お手数ですが、関係各所に回覧願います。 >>